

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部**成分表**

製品名(鉛フリー): XC8108xxxxER-G

標準質量: 6 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.440	シリコン	73400	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	1.100	ニッケル	183400	7440-02-0
		銀	14600	7440-22-4
		金	2700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.020	エポキシ樹脂	3300	—
		溶融シリカ	2700	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.118	金	19700	7440-57-5
封止樹脂	3.781	溶融シリカ	630200	60676-86-0
		エポキシ樹脂	38500	—
		フェノール樹脂	31500	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。